

# 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: Customer \_\_\_\_\_

货 名: Description 贴片 SMD 3068 音叉石英晶体谐振器

客户料号: Part No \_\_\_\_\_

物料编号: Code No S36003271C2070DY

频 率: Frequency 32.768KHz

日 期: Date 2020-09-21

备 注: RoHS compliance with Directive (EU) 2015/863

制作(Prepare by)	检查(Check by)	批准 (Approve by)
江丹娜	甘瑛	张刚

客户批准 Approve by customer	
批准日期 Approval date	

Add: 广东省深圳市华发北路桑达工业区桑达雅苑 7P

7 P Sangda Yayuan Huafa North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong

Tel: 86-755-83048260

86-755-83048290

Fax: 86-755-83048280

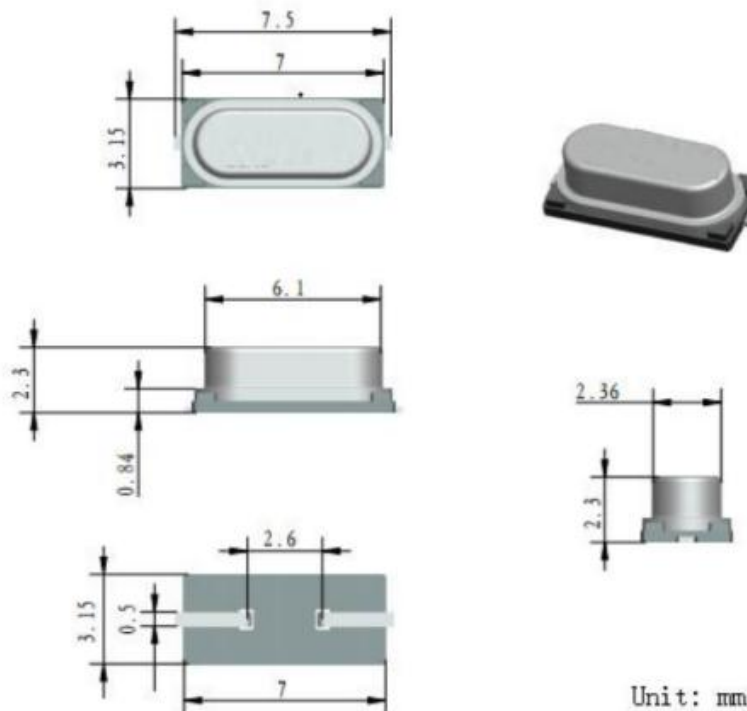
## 1、 Specifications

1	规格型号 Holder Type	SMD 3068
2	标称频率 Nominal Frequency	32.768KHz
3	晶片切型 TYPE	TF
4	调整频差 Frequency Tolerance at 25℃	±20ppm
5	温度频差 Temperature Frequency Stability	-0.034±0.006 ppm/℃ <sup>2</sup>
6	工作温度 Operating Temperature Range	-20~70℃
7	贮存温度 Storage Temperature Range	-40~85℃
8	负载电容 Load Capacitance	12.5pF
9	等效电阻 Equivalent Series Resistance	70 KΩ Max
10	静态电容 Static capacitance(C0)	≤1.0 pF
11	动态电容 Dynamic capacity( C1)	≤3 fF
12	激励功率 Drive Level	0.1uW
13	绝缘阻抗 Insulation Resistance	500MΩ min./DC100V
14	老化率 1st. Year at 25℃	±3ppm
15	最小包装 Packing Unit	3,000pcs/Reel

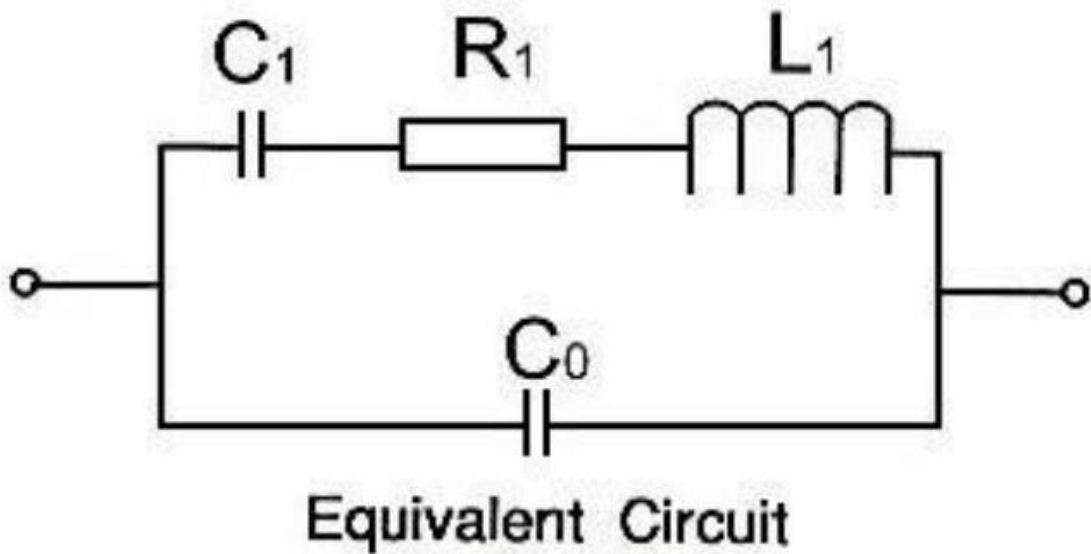
### 温馨提示:

1. 手动焊接 350℃最大值 4 秒
2. 清洗晶体谐振器可能会被超声波清洗破坏，我们无法保证用这种清洗方法清洗产品的质量，因为不能确定清洗机的类型、功率、时间、清洗槽的位置等条件。当必须使用这种清洗方法时，请确认超声波清洗在使用前不会对产品造成任何损害

## 2.Dimensions

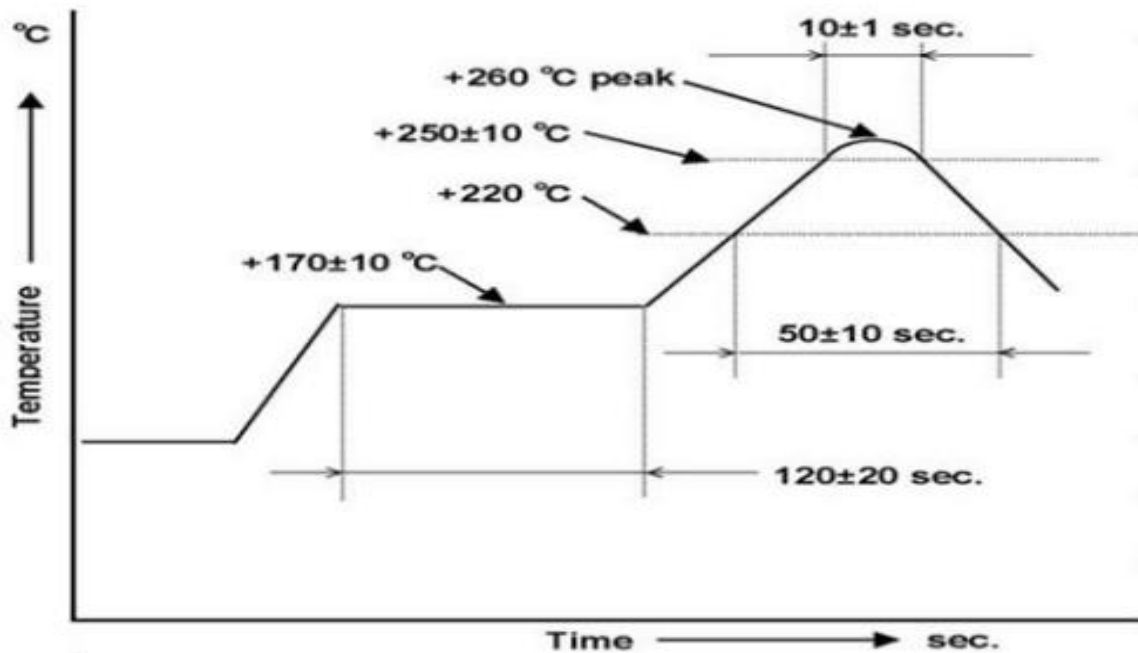


2. 等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT

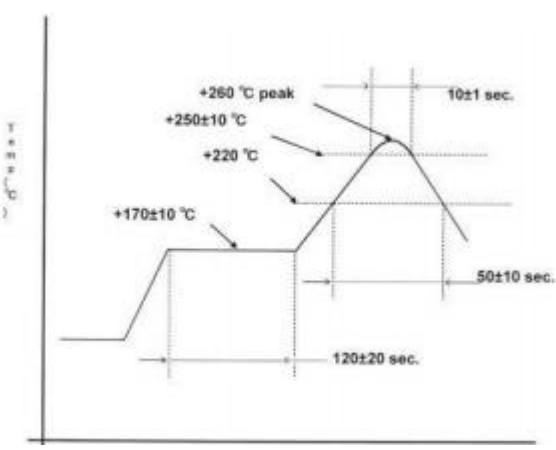


4. Recommended Reflow profile

Condition:



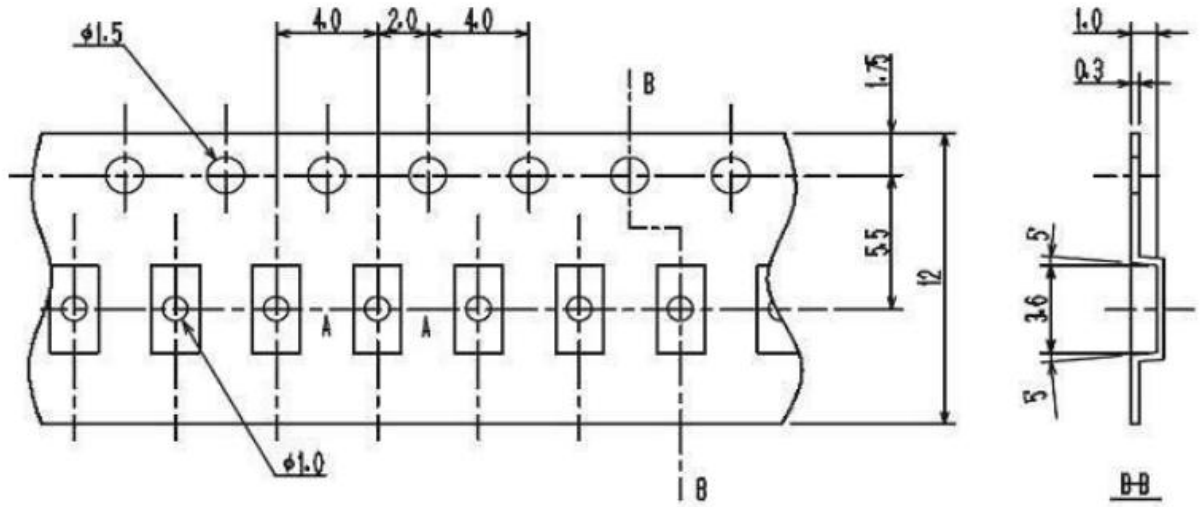
### 5、可靠性项目 RELIABILITY SPECIFICATION

序号	项目	变化量	环境因素	备注
1	高温特性	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 125℃ 以下贮存 1000 小时后，室温下测量。	*1 *3
2	低温特性	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 -40℃ 以下贮存 1000 小时后，室温下测量。	*1 *3
3	高温耐湿试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 85±2℃ 下储存，85%Rh，1000h 后，在室温下进行测量。	*1 *3
4	高低冲击试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	循环 100 次后在室温下测量。 -55℃ ⇌ 125℃，30 分钟	*1 *3
5	自由跌落	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	(SII 标准) 1500 mm 高度 3 个方向自由跌落到混凝土 10 次。	*2
6	振动试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	振幅 1.5mm 和 10~60 hz，周期时间 2~3 min，向 3 个方向(x、y、z 轴)各 2 h。	*2
7	强度试验	禁止剥落	压力 10n×10±1 秒，按 IEC 60068-2-21 标准	*2
8	剥离试验	禁止剥落	压力 10n×10±1 秒，按 IEC 60068-2-21 标准	*2
9	弯曲试验	禁止剥落	弯曲：3mm×5±1 秒。测试板厚度：1mm。	*2
10	回流焊	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	这里使用的温度是指电路板上的温度。 允许回流 2 次 	*1

**备注:**

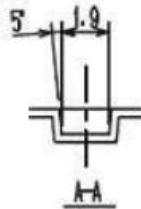
1. 每项测试须独立进行。(不能串联测试)
2. \*1: 在室温下 24 小时后测量。
3. \*2: 室温下 2 小时后测量。
4. \*3: 前提条件(1) 回流焊: 2 次  
(2) 初始值应在室温下 24 小时后测量。
5. 上述试验后串联电阻的位移应小于±20%或小于±15kΩ。过回流焊和高温储存(±125℃, 1000 小时)的情况下, 试验后串联电阻的位移应小于±30%或±20kΩ。

6、编带卷盘规格 REEL SPECIFICATION

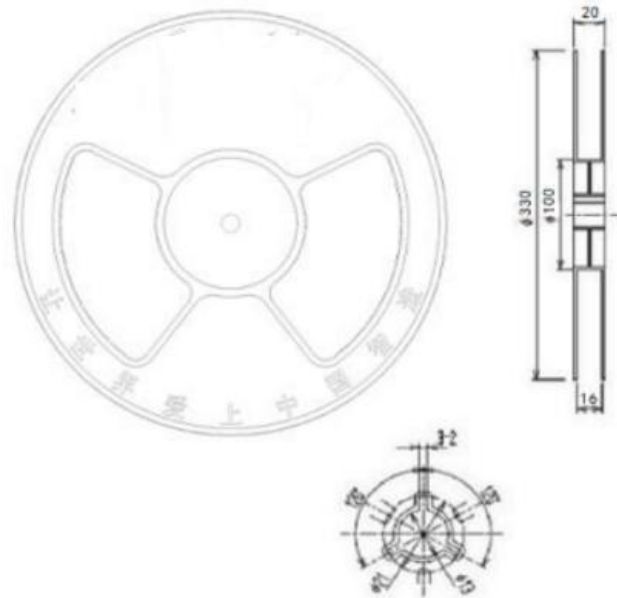


备注:

符合: EIA-481  
公差:  $\pm 0.2\text{mm}$   
单位: mm



名称	规格	单位
材料	PS	
内卷 W1	$16.0 \pm 0.5$	mm
外卷 W2	$20 \pm 1.0$	mm



备注: 每盘 3000pcs